

**Données OMNIMATE - Prises RJ45
RJ45C3 S1U 0.9N4N RL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



La gamme de produits couvre les formes verticale et horizontale, ainsi que les versions avec crochet de verrouillage en haut et en bas.

- Systèmes de soudure THT, THR ou SMD
- Large gamme de formes, également avec des LED intégrées et des languettes de contact blindage
- Version emballée sur plateau (TY) ou en rouleau (Tape-on-Reel, RL)
- Plage de température étendue de -40 °C à $+85\text{ °C}$
- Couche d'or renforcée pour une protection contre la corrosion améliorée
- Vitesses de transmission jusqu'à 1 Gbit/s

Informations générales de commande

Type	RJ45C3 S1U 0.9N4N RL
Référence	1455220000
Version	Connecteur pour circuit imprimé, Prises RJ45, Raccordement soudé SMD, 1.27 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, Or sur nickel, noir, Tape (Ø 330 mm); $R_s = 10^9 - 10^{12}\ \Omega$
GTIN (EAN)	4050118261516
Cdt.	200 pièce(s)
Emballage	Tape (Ø 330 mm); $R_s = 10^9 - 10^{12}\ \Omega$

Fiche de données

Données OMNIMATE - Prises RJ45 RJ45C3 S1U 0.9N4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 3,6 g

Températures

Température de fonctionnement, max.	85 °C	Température de fonctionnement, min.	-40 °C
Température de stockage, max.	85 °C	Température de stockage, min.	-40 °C

Caractéristiques du système

Angle de sortie	90°	Blindage	Oui
Catégorie	Cat.3	Circuit	8 brins
Cycles d'enfichage	750	Degré de protection	IP20
Emballage	Tape (Ø 330 mm); Rs = 10 ⁹ - 10 ¹² Ω	Famille de produits	Données OMNIMATE - Prises RJ45
LED	Non	Languettes de blindage	aucun
Longueur du picot à souder (l)	3,5 mm	Matériau de blindage	Alliage de cuivre
Montage sur le circuit imprimé	Raccordement soudé SMD	Nombre de picots par pôle	1
Nombre de pôles	8	Option de verrouillage	haut
Pas en mm (P)	1,27 mm	Pas en pouces (P)	0,05 inch
Surface de blindage	nickelé	Type de raccordement	Femelle

Propriétés électriques

Courant nominal	1,5 A	Rigidité diélectrique, contact - contact	≥ 1000 V DC
Résistance d'isolation	> 500 MΩ	Tension nominale	125 V AC

Caractéristiques des matériaux

Matériau isolant	PA 9T	Couleur	noir
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 9011	Groupe de matériaux isolants	II
CTI	≥ 500	Résistance d'isolation	> 500 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Matériau de base du contact	Bronze phosphoreux	Surface du contact	Or sur nickel
Structure en couches du contact mâle	30-80 μ" Ni / 30- μ" Au	Température de stockage, min.	-40 °C
Température de stockage, max.	85 °C	Température de fonctionnement, min.	-40 °C
Température de fonctionnement, max.	85 °C		

Classifications

ETIM 6.0	EC002637	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-25		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Fiche de données**Données OMNIMATE - Prises RJ45
RJ45C3 S1U 0.9N4N RL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Téléchargements**

Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 15/16 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

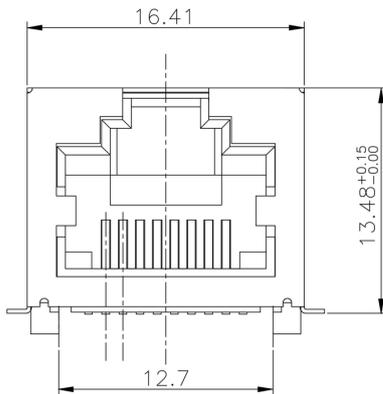
Fiche de données

**Données OMNIMATE - Prises RJ45
RJ45C3 S1U 0.9N4N RL**

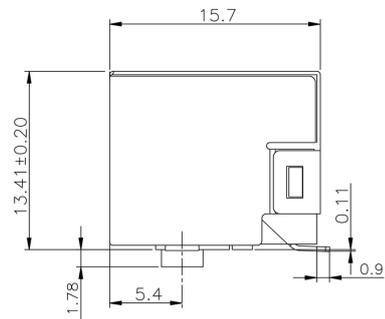
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dessins

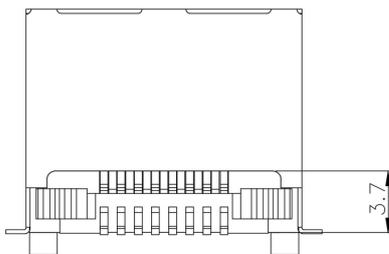
Dessin coté



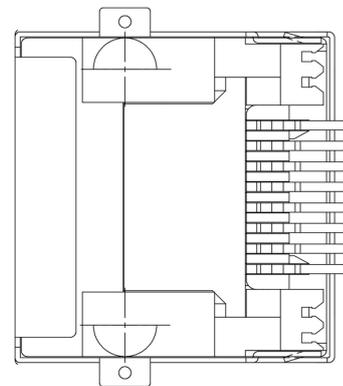
Dessin coté



Dessin coté

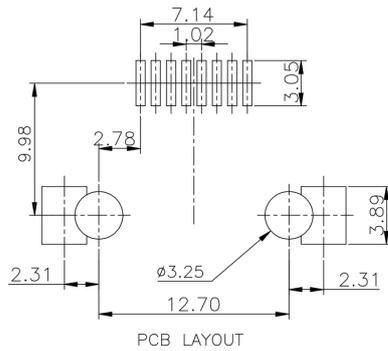


Dessin coté



Fiche de données**Données OMNIMATE - Prises RJ45
RJ45C3 S1U 0.9N4N RL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins**Conception de la plaque de circuit imprimé**

Fiche de données

Données OMNIMATE - Prises RJ45 RJ45C3 S1U 0.9N4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

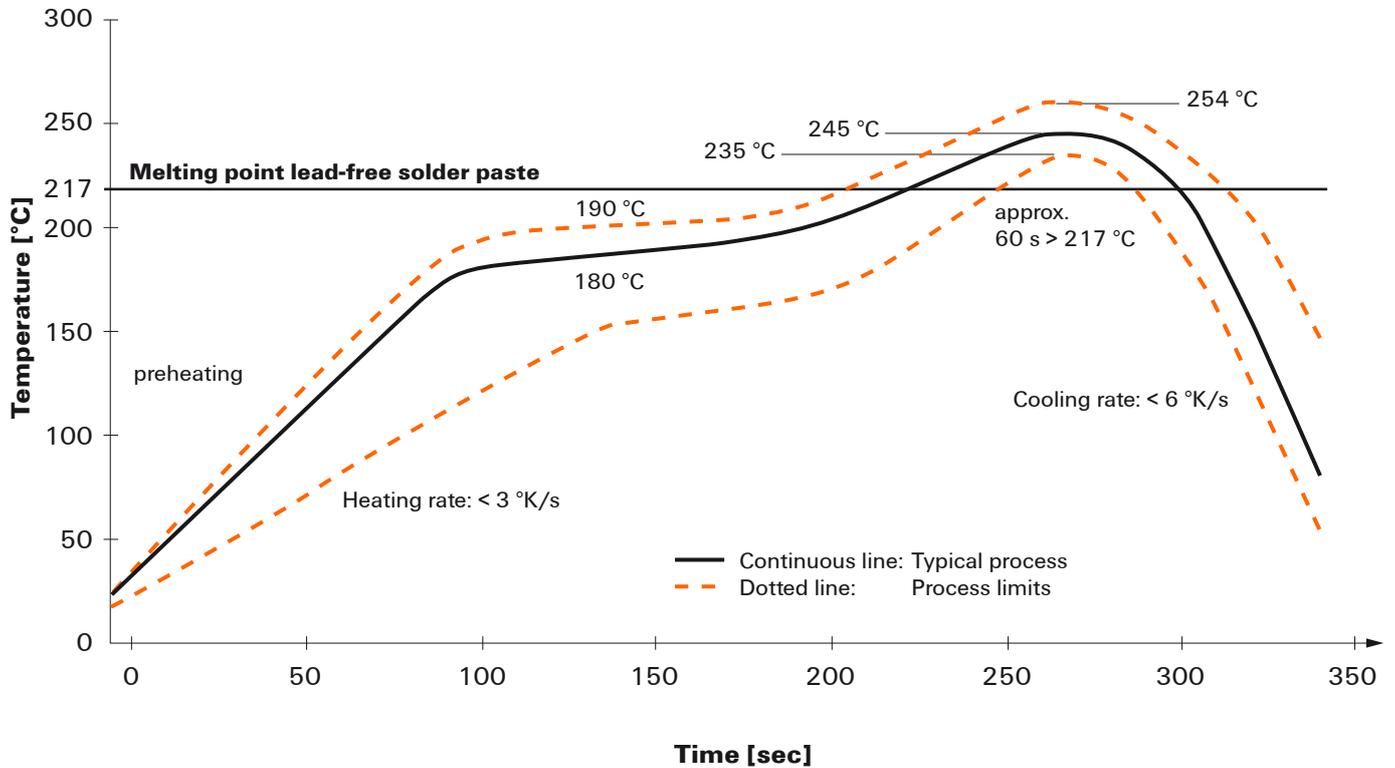
Dessins

Legend

Code	Value	Description
RJ45	G1	RJ45G1
	R1	R1
	U	U
	3.2	3.2
	E4	E4
	GY/GY	GY/GY
	TY	TY
RJ45G1 R1U 3.2E4GY/GY TY		
Packaging	TY	Tray in box (manual assembly)
	RL	Tape on Reel (automated assembly)
LED	Y/G	Yellow/Green
	G/Y	Green/Yellow (standard)
	GY/GY	Green-Yellow/Green-Yellow
	O/G	Orange/Green
	R/O	Red/Orange
 (further combinations possible)
	N	without LED
Contact surface thickness	4	1 = 3µ, 2 = 6µ, 3 = 15µ, 4 = 30µ, 5 = 50µ
EMI tabs (ground fingers)	E	E = with EMI tabs
	N	N = without EMI tabs
Solder Pin length	3.2	3.2 mm
	1.6	1.6 mm
	D	SMD
Direction, latch style	U	Horizontal (90°, side entry), latch up
	D	Horizontal (90°, side entry), latch down
	V	Vertical (180°, top entry)
	Y	Diagonal (45°), latch up
Number of Ports	1	1 Port
	12; 14; ...	multi ports side by side, Multiport
	21; 41; ...	multi ports about each other, Multilevel
Assembly on PCB	R	Through Hole Reflow - THR
	S	Soldering process: Wave or Reflow soldering
	SMT	Surface Mount Technology - SMT
	T	Soldering process: Reflow soldering
	THT	Through Hole Technology - THT
	Wave	Soldering process: Wave
Performance Category	C5	Category 5
	C6	Category 6
	C6A	Category 6A
	C5e	Category 5e
	M	10/100 Mbit
	G1	10/100/1000 Mbit
	G10	10 Gbit
	U	Unshielded
	MP	10/100 Mbit with POE
	MP+	10/100 Mbit with POE+

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is ‚activated‘. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.